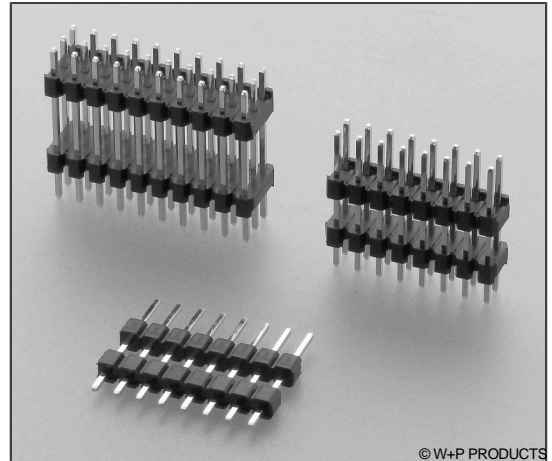


# 949 / 950 / 951

Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-/3-reihig  
Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, 1/2/3 Rows

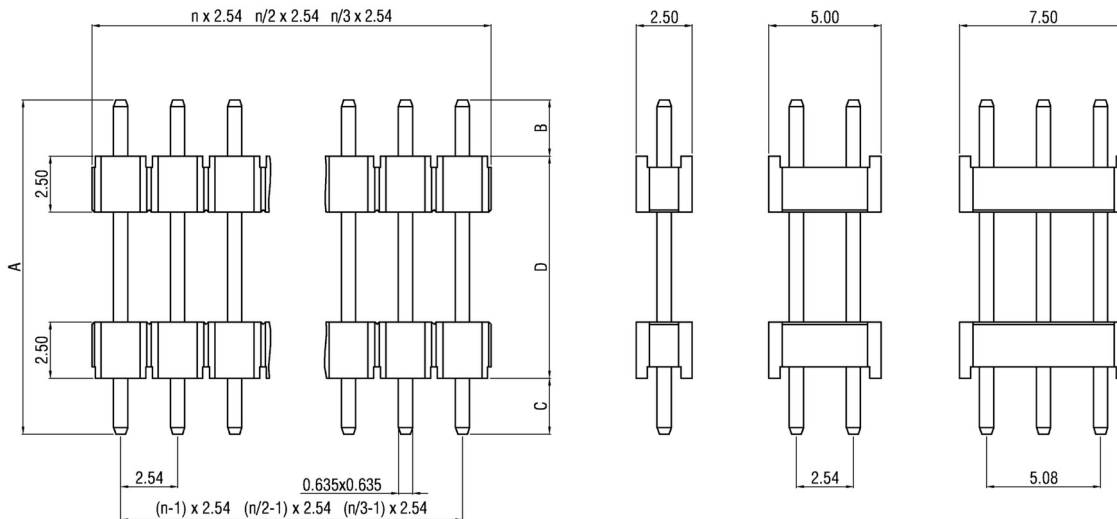
## Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV DC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**153 154 157 159 160/162 349 624** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12  
*Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.*

### Series \*

**949**

Gestanzte/geprägte Kontakte  
*Stamped/formed contacts*  
**949** Einreihig  
*Single row*  
**950** Zweireihig  
*Double row*  
**951** Dreireihig  
*Triple row*

### Dimensions \*

**19**

**16** A=17,70 B=5,70 C=3,30 D=8,70mm  
**17** A=19,80 B=5,70 C=3,30 D=10,80mm  
**18** A=21,60 B=5,70 C=3,30 D=12,60mm  
**19** A=22,80 B=5,70 C=3,30 D=13,80mm  
**20** A=24,90 B=5,70 C=3,30 D=15,90mm  
**21** A=26,70 B=5,70 C=3,30 D=17,70mm  
**22** A=29,00 B=5,70 C=3,30 D=20,00mm  
**23** A=30,80 B=5,70 C=3,30 D=21,80mm  
**24** A=37,80 B=5,70 C=3,30 D=28,80mm  
**25** A=40,80 B=5,70 C=3,30 D=31,80mm  
**26** A=45,30 B=5,70 C=3,30 D=36,30mm  
**A/B/C/D** Gesamtlänge & Wunschmaße  
*Total length & Dimensions*

### Contacts \*

**010**

**001-050** Einreihig  
*Single row*  
**004-100** Zweireihig  
*Double row*  
**006-120** Dreireihig  
*Triple row*

### Plating \*

**00**

**00** Au flash  
**110** Sel. Au 0,25µm / flash  
**130** Sel. Au 0,75µm / flash  
**50** Sn  
**66** Sel. Au flash / Sn  
**610** Sel. Au 0,25µm / Sn  
**80** Sel. Au 0,75µm / Sn  
Au flash <= 0,1µm  
Au flash <= 0,1µm

B, C, D nach Kundenwunsch variierbar. Wir fertigen die  
Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm,  
7,62mm, etc. oder Sonderraster auf Anfrage. Bestellseite  
"Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter Techn.  
Informationen.

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

*B, C, D variable acc. to customers' specifications. We will  
manufacture the pin headers in every desired number of  
contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches on  
request. Order page "Customer-specific Pin Configurations"  
in Technical Information.*

# Informationen zum Wellen-Lötverfahren

## Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

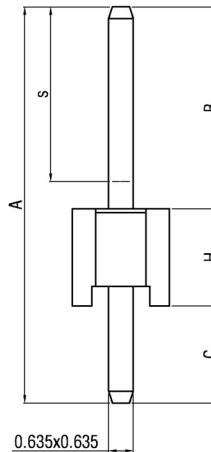
Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min



## Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

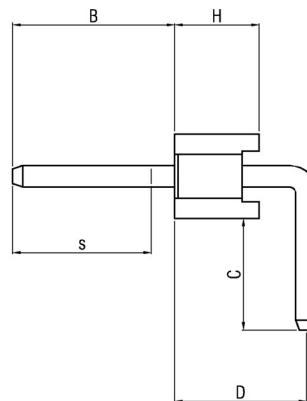
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



## Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



## PCB Layouts

